

免清洗锡膏 TQ01-SBA5800(5804)

华庆 TQ01-SBA5800 无铅低温免洗焊锡膏，由低氧化度锡粉与进口松香及高效活性剂在真空环境下混合而成。锡膏在回流时，活性能缓慢释放，焊料熔化后流动性好、润湿性强。此款锡膏可用于散热模组、LED 等不耐高温的产品。

TQ01-SBA5800 不含任何卤素。虽然在配方中排除了卤素，但突破性的配方设计，使其仍然具有卓越的焊接性能，回流后焊点光亮饱满、无发黑，残留物无色透明、无腐蚀，具有业界最高的安全性能。

TQ01-SBA5800 具有较宽的回流窗口，能适应多种回流曲线，粘度稳定，涂布性能良好。

性能特点

- ☆ 完全不含卤素，真正的无卤锡膏
- ☆ 润湿性优良，适用于镍、钯等难焊金属
- ☆ 粘度稳定性，良好的涂布性能
- ☆ 焊点饱满光亮、无发黑、无锡珠
- ☆ 焊接后焊点可靠性高，松香残留少，无色透明、无腐蚀性
- ☆ 可以在空气和氮气的环境下进行回流作业
- ☆ 适用的回流焊方式：红外线、气象式、对流式、传导式、热风式、雷射式。

基本特性

项目	数值	测试方法
合金成分	SBA5800: Sn42/Bi58 SBA5804: Sn42.6/Bi58/Ag0.4	JSTD-006
熔点	138°C	
金属含量	88.5%	IPC-TM-650 2.2.20
锡粉粒径	T3(25-45µm)	JSTD-005
粘度	140-180 Pa.s	IPC-TM-650 2.4.34
热坍塌性	≥0.4mm	IPC-TM-650 2.4.35
卤素含量	0	EN 14582:2007
锡球	极少	IPC-TM-650 2.4.43
扩展率	≥78%	IPC-TM-650 2.4.46
钢网寿命	>8 小时	@25°C, RH:50%
残留物粘性测试	合格	JIS Z 3284 附件 12

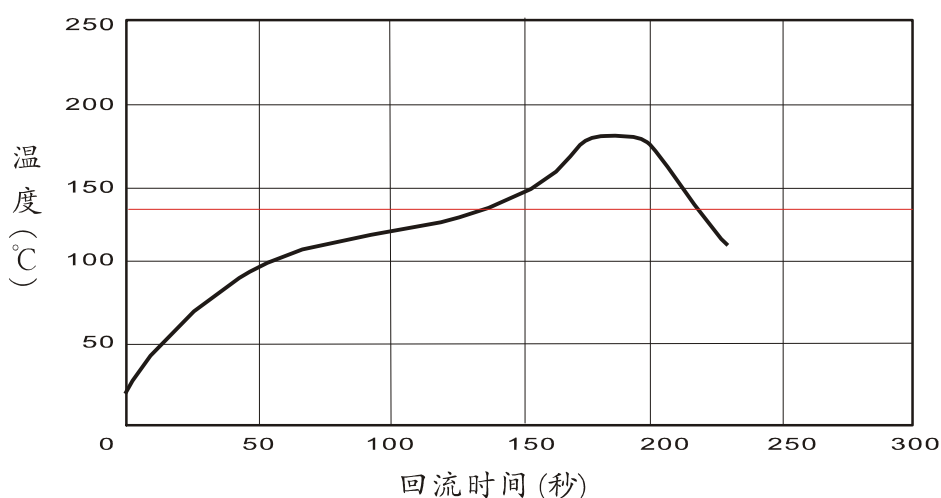
安全性能

项目	数值	测试方法
铜板腐蚀	合格 (无腐蚀)	IPC-TM-650 2.6.15
铜镜试验	合格 (无穿透)	IPC-TM-650 2.3.32
铬酸银测试	合格 (无变色)	IPC-TM-650 2.3.33
氟化物测试	合格 (无变色)	IPC-TM-650 2.3.35.1
表面绝缘电阻	合格 ($>10^8$ ohms)	IPC-TM-650 2.6.3.3
	合格 ($>10^{11}$ ohms)	Bellcore GR78-CORE

推荐回流参数

1. 预热区：以每秒 1-2°C 的升温速率将温度从室温匀速上升至 100°C。最大升温 2.5°C/s。
2. 保温区：用 60-150s 将温度从 100°C 平缓升至 138°C，最大升温 2.5°C/S，使 PCB 表面受热均匀。
3. 回流区：1) 根据不同产品,将峰值温度控制在 165-210°C 间。
2) 高于 138°C 以上的时间在 45-120s
4. 冷却区：推荐降温速率 $\geq 2^\circ\text{C}/\text{秒}$ ，最快降温为 4°C/s。过慢的冷却速度有时易造成器件移位及降低焊接强度,且冷却过快易增加残留物脆性。

推荐回流曲线



声明: 用户应根据各自的使用目的自行负责判断本资料信息的适宜性。虽然在编写此资料时已足够谨慎, 但此资料的准确性和适宜性不对用户的使用或使用结果负责或提供保证。